

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2026-0721-031

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☒ 其他：网络会议
参与单位名称	德邦基金、长江证券（本次会议采取网络会议形式，参会者均未签署书面调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。）
时间	2026 年 7 月 21 日 14:30-15:30
形式	网络会议
公司接待 人员姓名	钱元君
投资者关系活动 主要内容介绍	一、2026 年上半年公司经营业绩 公司已于近日披露 2026 年半年度业绩预告，受益于高速交换机、AI 服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构的持续优化，预计 2026 年上半年公司营业收入和净利润较上年同期均有较快增长；公司泰国子公司亦已从产能爬坡期逐步迈入规模化运营期，并于 2026 年第二季度实现单季扭亏为盈；2026 年第二季度汇兑损失较第一季度（汇兑损失约 1.48 亿元）有所减少。 二、经营策略及市场 1、数据通讯市场情况 AI 已从大规模预训练，全面拓展至以推理应用、商业化落地及全球化扩张的新阶段，大模型训练与推理需求双双迅速上升，AI 已成为数据中心基础设施的关键基石，大规模云数据中心向人工智能与高性能计算集群演变，促使全球主要云服务提供商（CSP）大幅增加资本支出，加速推动了 AI 服务器和

	高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为 PCB 行业带来了强劲的结构性增长动能。相应的，近年来面向数据通讯应用领域 PCB 需求的爆发式增长，一方面大量同行纷纷调整战略，将资源向该领域倾斜，意图通过激进的资本开支与产能扩张切入市场并取得一定的市场份额，随着行业产能的持续扩张，新增产能的逐步落地，成熟技术平台的准入门槛将被摊薄，未来的竞争或将趋向同质化与白热化，利润空间或将面临结构性挤压；另一方面 PCB 日渐成为数据通讯应用领域高阶硬件的重要赋能者，其技术跃迁正逐步重构 PCB 行业的竞争边界与价值分布格局，行业或将呈现“入场者多、通关者少”的格局，并驱使高阶 PCB 产品市场加速向具备全球化产能协同与顶尖研发积淀的行业头部梯队集中，呈现明显的结构性分化。 面对复杂的行业变局，公司历来不盲从于以规模 and 价格为导向的同质化扩张，而是全面深化差异化产品竞争战略，恪守“技术优先”的发展方针。公司深知，唯有技术突破才能跨越周期。公司深度锁定客户技术演进规划，努力将前沿技术的不确定性转化为可控的工程化实践，将研发端的技术前瞻性与制造端的大规模量产能力深度耦合，将优势资源倾斜于数据通讯应用领域高阶硬件所需的高附加值核心 PCB 产品，凭借卓越的创新能力、稳定可靠的品质口碑、国内和泰国的产能协同，与头部客户群体构筑深度的价值共同体，以期在激烈的市场重构中持续提升竞争力，在复杂多变的市场环境中锚定确定性，以求可持续高质量发展。 2、智能汽车市场情况 全球汽车 PCB 行业的竞争主线将围绕车规级可靠性、技术升级能力、平台化配套能力、全球交付能力以及精细化成本控制能力全面展开。公司依托长期技术积累和可靠品质，深化与客户在新能源车、ADAS、智能座舱、车联网等领域合作，加强关键技术研发与前期设计验证，持续优化产品和产能结构，以应对市场挑战。在智能汽车应用领域，公司继续在智能驾驶和电动化方向深耕。在智能驾驶方面为满足 L3、L4 等级智能驾驶的需求，更高算力的硬件结构对 PCB 提出诸多挑战，公司针对高可靠性材料、精细线路、高纵深比的电镀能力、更高阶 HDI 能力、更小镭射孔径加工能力、更高对准度等方面开展研发；在电动化方面，公司进一步加大投入高压 P²Pack 技术开发，与多家主流新势力车企及其核心供应商紧密合作，面向汽车 800V 高压驱动平台开展产品测试认证。公司也正与数据通讯领域核心客户共同积极探索 P²Pack 技术在
--	---

	数据中心场景的应用，以优化芯片与 PCB 之间的传热路径，降低系统的热阻，从而提高系统的功率密度和散热效率。 三、全面统筹并稳步推进国内外产能的有序扩张与前瞻布局 1、在国内兼顾短期效益与长期发展，一方面聚焦高阶 PCB 的瓶颈及关键制程，实施迭代升级与靶向性产能扩充，持续深挖现有厂区的高附加值产出潜力，另一方面，加快推进高端扩产项目的建设，2026 年第一季度公司加速启动了一系列产能扩充计划。公司于 2026 年 6 月收购昆山普江仓储设施有限公司（下称“普江仓储”）100%股权，将普江仓储的厂房用于产能扩建。2026 年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约 14.67 亿元，接近去年的一半。 扩产并非简单的规模复制，而是分阶段达成产能的升级式扩容，旨在提前卡位优质产能，以更好地满足头部客户群体的需求。通过着力强化国内外各生产基地的资源协同效应，逐步构建起多维一体、梯次有序的国内外产能梯次矩阵，有效化解地缘政治与供应链重构的潜在风险，动态适配数据通讯与智能汽车等核心领域日益增长的市场需求，为公司长期高质量发展编织牢固的国内外生产供应网络。 除上述外，公司还规划在常州金坛搭建 CoWoP 等前沿技术与 mSAP 等先进工艺的孵化平台，构建“研发-中试-验证-应用”的闭环体系，布局光铜融合等下一代技术方向，系统提升产品的信号传输、电源分配及功能集成能力，待相关技术工艺验证成熟并具备产业化条件后，投建高密度光电集成线路板的规模化生产线。需要强调的是 CoWoP、mSAP 及光铜融合等前沿技术研发，具有研发周期长、技术难度高、工艺复杂等特点。在研发过程中可能面临技术路线偏差、关键工艺无法突破或商业化转化进度不及预期等风险。 2、针对供应链可能出现的瓶颈，主动而且战略性地深化合作与协同创新机制。伴随高阶 PCB 向超低损耗树脂、超低轮廓铜箔（HVLP）及特种高性能玻纤布加速演进，严苛的工艺壁垒与良率瓶颈致使部分高端原材料面临阶段性的产能受限，供应偏紧状态。公司在终端客户产品开发的极早期便全面介入，提前参与新一代高端材料的电性能验证与可靠性测试等，缩短材料认证周期，确保在供应紧张时获得优先配额保障；同时全面落实关键物料的战略安全库存，并加速推进多元化与本地化认证，减少原物料断供风险，强化具有韧性的供应链安全壁垒。
--	---

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无